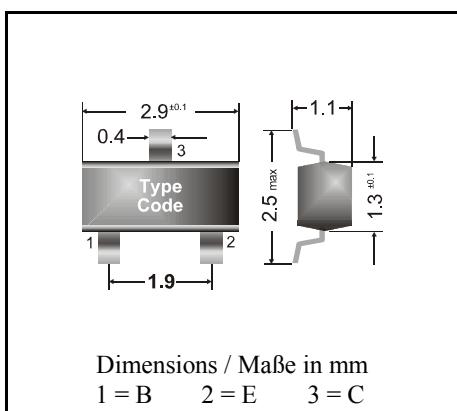


PNP

### Surface mount Si-Epitaxial PlanarTransistors Si-Epitaxial PlanarTransistoren für die Oberflächenmontage

PNP



Power dissipation – Verlustleistung	250 mW
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

**Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

<b>BFN 23</b>		
Collector-Emitter-voltage B open	- $V_{CEO}$	250 V
Collector-Base-voltage E open	- $V_{CBO}$	250 V
Collector-Emitter-voltage $R_{BE} = 2.7 \text{ k}\Omega$	- $V_{CER}$	250 V
Emitter-Base-voltage C open	- $V_{EB0}$	5 V
Power dissipation – Verlustleistung	$P_{tot}$	250 mW <sup>1)</sup>
Collector current – Kollektorstrom (dc)	- $I_C$	50 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom	- $I_{CM}$	100 mA
Junction temperature – Sperrschiichttemperatur	$T_j$	150 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_s$	- 65...+ 150 °C

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )****Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

	<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom $I_E = 0, - V_{CB} = 200 \text{ V}$	- $I_{CB0}$	–	100 nA
$I_E = 0, - V_{CB} = 200 \text{ V}, T_j = 150^\circ\text{C}$	- $I_{CB0}$	–	20 $\mu\text{A}$
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom $- V_{CB} = 250 \text{ V}, R_{BE} = 2.7 \text{ k}\Omega$	- $I_{CBR}$	–	1 $\mu\text{A}$
$- V_{CB} = 250 \text{ V}, R_{BE} = 2.7 \text{ k}\Omega, T_j = 150^\circ\text{C}$	- $I_{CBR}$	–	50 $\mu\text{A}$
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom $I_C = 0, - V_{EB} = 5 \text{ V}$	- $I_{EB0}$	–	10 $\mu\text{A}$

<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 3  $\text{mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3  $\text{mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspg. <sup>1)</sup> - $I_C = 10 \text{ mA}$ , - $I_B = 1 \text{ mA}$	- $V_{CEsat}$	–	–	500 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>1)</sup> - $I_C = 10 \text{ mA}$ , - $I_B = 1 \text{ mA}$	- $V_{BEsat}$	–	–	1 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup> - $V_{CE} = 20 \text{ V}$ , - $I_C = 25 \text{ mA}$	$h_{FE}$	50	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz - $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , - $I_C = 10 \text{ mA}$ , $f = 20 \text{ MHz}$	$f_T$	–	100 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität - $V_{CB} = 30 \text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{CB0}$	–	0.8 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{thA}$		420 K/W <sup>2)</sup>
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren			BFN 22	

Marking - Stempelung

BFN 23 = HC

<sup>1)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$ <sup>2)</sup> Mounted on P.C. board with  $3 \text{ mm}^2$  copper pad at each terminalMontage auf Leiterplatte mit  $3 \text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß